

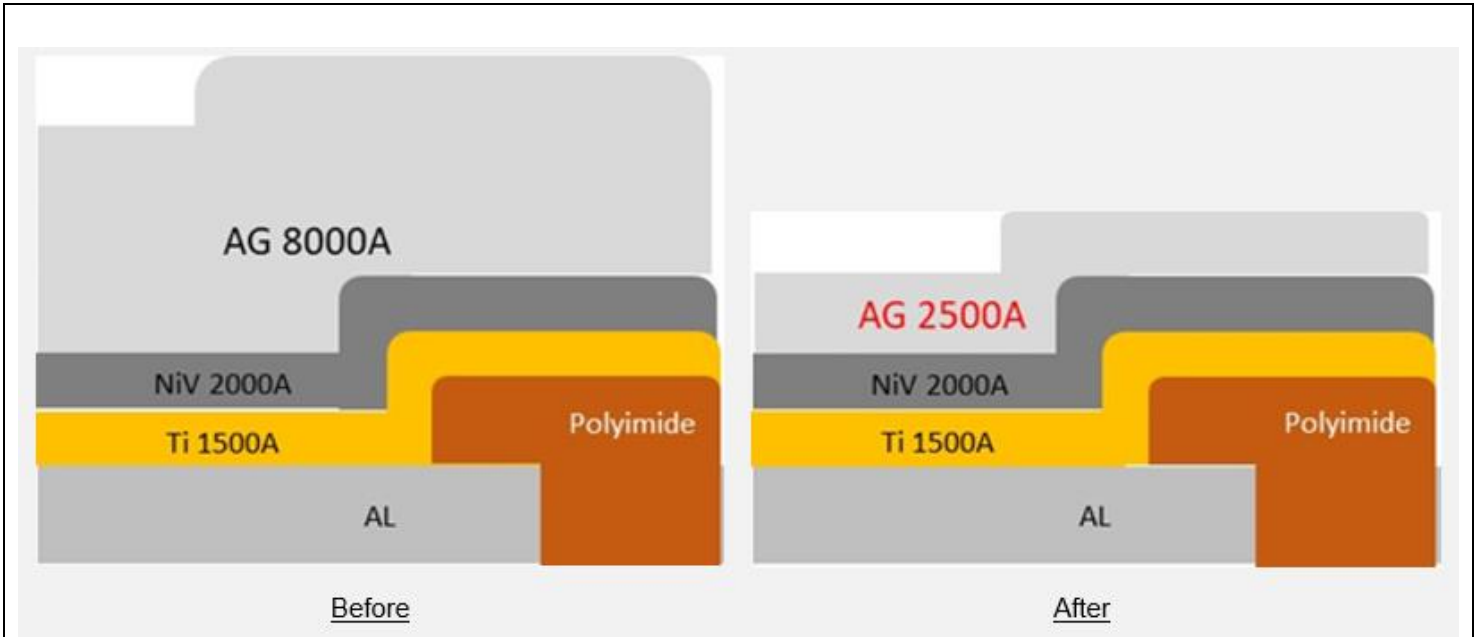


Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN24223X

Issue Date: 26 Aug 2021

Title of Change:	STM Thickness Change for T6/T8 Wafer Technology Fabricated in onsemi Aizu, Japan	
Proposed First Ship date:	07 Jul 2022 or earlier if approved by customer	
Contact Information:	Contact your local onsemi Sales Office or guokun.yeng@onsemi.com	
PCN Samples Contact:	Contact your local onsemi Sales Office or < PCN.samples@onsemi.com >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.	
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < PCN.Support@onsemi.com >	
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Lot traceability will provide upon customer request	
Change Category:	Wafer Fab Change	
Change Sub-Category(s):	Material Change	
Sites Affected:		
onsemi Sites		External Foundry/Subcon Sites
onsemi Aizu, Japan		None
Description and Purpose:		
<p>This Product Change Notification is to announce that onsemi is changing STM (solderable top metal) Ag layer thickness from 8000A to 2500A in Trench 6/Trench 8 wafer technology in onsemi Aizu, Japan. Purpose of this change is for wafer fab manufacturing capacity improvement.</p> <p>Die size, die thickness, die layout will remain the same.</p> <p>No change to orderable part number.</p> <p>There is no product marking change as a result of this change</p>		



Qualification Plan:

QV DEVICE NAME; NVMFS6H800NLT1G

RMS: TBD

PACKAGE: SO8FL—HE

Test	Specification	Condition	Interval
PC	J STD 020 , JESD22-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cycles
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 hours
IOL + PC	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min= Ton=Toff (pkg dependent)	15000 cycles
RSH + PC	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	End points
SAT	12MSB17722C	12MSB17722C	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	
Yield		per assembly MRB procedure	

QV DEVICE NAME; NVMFS5C604NWFT1G

RMS: TBD

PACKAGE: SO8FL—HE

Test	Specification	Condition	Interval
PC	J STD 020 , JESD22-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cycles
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 hours
IOL + PC	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min= Ton=Toff (pkg dependent)	15000 cycles



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN24223X

Issue Date: 26 Aug 2021

RSH + PC	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	End points
SAT	12MSB17722C	12MSB17722C	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	
Yield		per assembly MRB procedure	

QV DEVICE NAME; NVMTS0D7N06CTXG

RMS: TBD

PACKAGE: PQFN 8x8

Test	Specification	Condition	Interval
PC	J STD 020 , JESD22-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cycles
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 hours
IOL + PC	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min= Ton=Toff (pkg dependent)	15000 cycles
RSH + PC	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	End points
SAT	12MSB17722C	12MSB17722C	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	
Yield		per assembly MRB procedure	

QV DEVICE NAME; NVMTS1D2N08H

RMS: TBD

PACKAGE: PQFN 8x8

Test	Specification	Condition	Interval
PC	J STD 020 , JESD22-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cycles
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 hours
IOL + PC	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min= Ton=Toff (pkg dependent)	15000 cycles
RSH + PC	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	End points
SAT	12MSB17722C	12MSB17722C	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	
Yield		per assembly MRB procedure	

QV DEVICE NAME; NTMF55C612NLT1G

RMS: TBD

PACKAGE: SO8FL

Test	Specification	Condition	Interval
PC	J STD 020 , JESD22-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cycles
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 hours
IOL + PC	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min= Ton=Toff (pkg dependent)	15000 cycles
RSH + PC	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	End points
SAT	12MSB17722C	12MSB17722C	



Initial Product/Process Change Notification

Document #: IPCN24223X

Issue Date: 26 Aug 2021

Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	
----------	--	--	--

QV DEVICE NAME; NTTFS6H850NTAG

RMS: TBD

PACKAGE: u8FL

Test	Specification	Condition	Interval
PC	J STD 020 , JESD22-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cycles
UHASt+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 hours
IOL + PC	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min= Ton=Toff (pkg dependent)	15000 cycles
RSH + PC	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	End points
SAT	12MSB17722C	12MSB17722C	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	

Estimated date for qualification completion: 25 February 2022

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

To view attached Parts Lists:

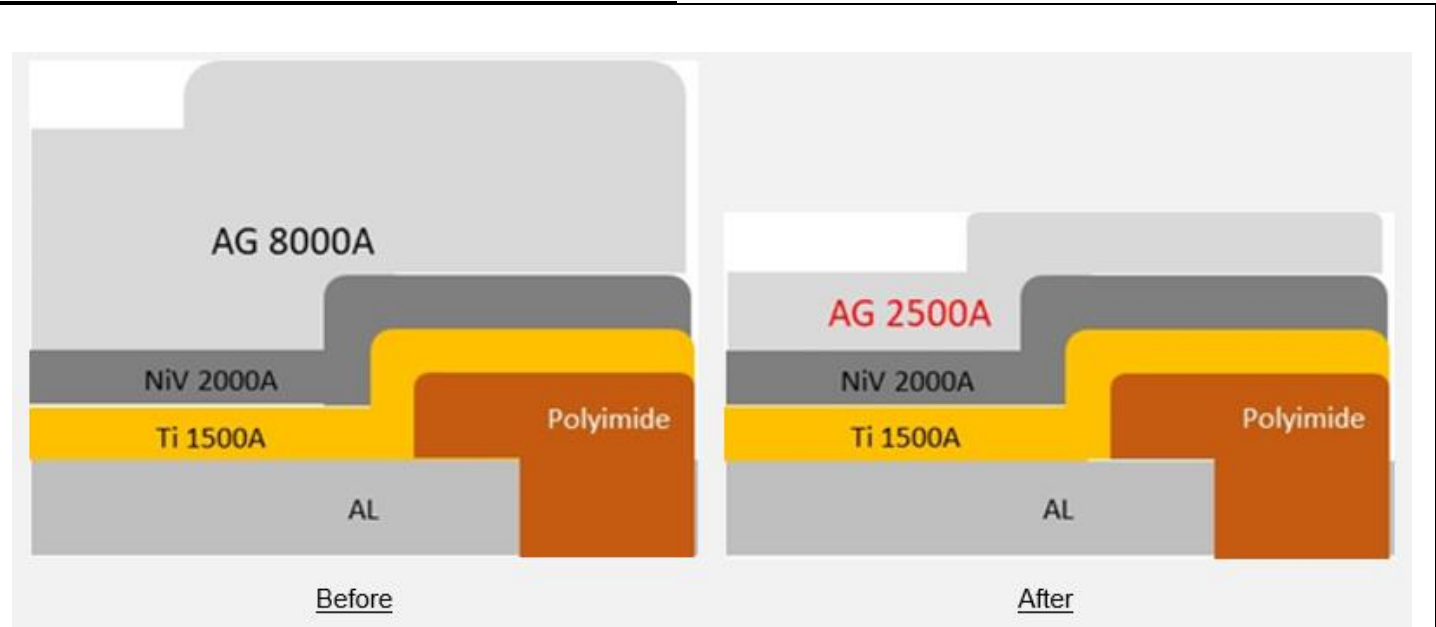
1. Download pdf copy of the PCN to your computer
2. Open the downloaded pdf copy of the PCN
3. Click on the paper clip icon available on the menu provided in the left/bottom portion of the screen to reveal the Attachment field
4. Then click on the attached file

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。

変更件名:	日本のオンセミ会津拠点にて製造される T6/T8 ウェーハ技術における STM 厚の変更	
初回出荷予定日:	2022 年 7 月 7 日またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < guokun.yeng@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回 PCN または最終 PCN の最初の通知の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、< PCN.Support@onsemi.com > にお問い合わせください。	
部品のマーキング/変更のトレーサビリティ:	ロット追跡はお客様のご要望に応じて提供されます	
変更カテゴリ:	ウェハファブ変更	
変更サブカテゴリ:	材料の変更	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
onsemi Aizu, Japan	なし	
説明および目的:		
<p>この製品変更通知は、日本のオンセミ会津拠点でのトレンチ 6/トレンチ 8 ウェーハ技術における STM (solderable top metal、はんだ付け可能なトップメタル) Ag レイヤーの厚さを 8000A から 2500A に変更する旨をお知らせするものです。今回の変更は、ウェーハ製造の生産能力の向上を目的とするものです。</p> <p>ダイのサイズ、厚さ、レイアウトへの変更はありません。</p> <p>発注可能部品番号への変更はありません。</p> <p>今回の変更に伴う製品表示の変更はありません。</p>		



認定計画:

デバイス名: NVMF56H800NLT1G
 RMS: TBD
 パッケージ: SO8FL—HE

テスト	規格	条件	間隔
PC	J STD 020 , JESD22-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cycles
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 hours
IOL + PC	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min= Ton=Toff (pkg dependent)	15000 cycles
RSH + PC	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	End points
SAT	12MSB17722C	12MSB17722C	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	
Yield		per assembly MRB procedure	

デバイス名: NVMF55C604NWFT1G
 RMS: TBD
 パッケージ: SO8FL—HE

テスト	規格	条件	間隔
PC	J STD 020 , JESD22-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cycles
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 hours
IOL + PC	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min= Ton=Toff (pkg dependent)	15000 cycles

RSH + PC	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	End points
SAT	12MSB17722C	12MSB17722C	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	
Yield		per assembly MRB procedure	

デバイス名: NVMTS0D7N06CTXG

RMS: TBD

パッケージ: PQFN 8x8

テスト	規格	条件	間隔
PC	J STD 020 , JESD22-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cycles
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 hours
IOL + PC	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min= Ton=Toff (pkg dependent)	15000 cycles
RSH + PC	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	End points
SAT	12MSB17722C	12MSB17722C	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	
Yield		per assembly MRB procedure	

デバイス名: NVMTS1D2N08H

RMS: TBD

パッケージ: PQFN 8x8

テスト	規格	条件	間隔
PC	J STD 020 , JESD22-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cycles
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 hours
IOL + PC	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min= Ton=Toff (pkg dependent)	15000 cycles
RSH + PC	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	End points
SAT	12MSB17722C	12MSB17722C	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	
Yield		per assembly MRB procedure	

デバイス名: NTMF55C612NLT1G

RMS: TBD

パッケージ: SO8FL

テスト	規格	条件	間隔
PC	J STD 020 , JESD22-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cycles
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 hours
IOL + PC	MIL STD750, M 1037 Q101 AEC	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min= Ton=Toff (pkg dependent)	15000 cycles
RSH + PC	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	End points

SAT	12MSB17722C	12MSB17722C	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	

デバイス名: NTTFS6H850NTAG

RMS: TBD

パッケージ: u8FL

テスト	規格	条件	間隔
PC	J STD 020 , JESD22-A113	IR reflow at 245C or 260C (pkg dependant)	
HAST+PC	JESD22-A110	Temp = 130C, 85% RH, ~ 18.8 psig, bias = 80% of rated V or 100V max	96 hours
TC+PC	JESD22-A104	Temp = -55°C to +150°C; for 1000 cycles	1000 cycles
UHAST+ PC	JESD22-A118	Temp = 130C, RH=85%, ~ 18.8 psig	96 hours
IOL + PC	MIL STD750, M 1037 AEC Q101	Ta=+25°C, deltaTj=100°C max, 2 min= Ton=Toff (pkg dependent)	15000 cycles
RSH + PC	JESD22-B106	Ta=265C 10 sec dwell B106	End points
SAT	12MSB17722C	12MSB17722C	
Tri-Temp		Characterization of all 48A parameters	

認定完了予定日: 25 February 2022

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

添付された部品リストの表示:

1. ご使用のコンピューターに PDF 版の PCN をダウンロードします。
2. ダウンロードした PDF 版の PCN を開きます。
3. 添付欄を見るには、画面左 / 下部分のメニュー上にあるクリップアイコンをクリックしてください。
4. 添付ファイルをクリックします